一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报公司合并报表累计未分配利润为-160,600,767万元，母公司财务报表累计未分配利润为-1,830,677万元，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司的控股股东情况及关联人情况

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所创板	芯原股份	688521	不适用	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式			
姓名	施文茜	石乃路	
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A	
电话	021-5133 4800	021-5133 4800	
电子信箱	IR@verisilicon.com	IR@verisilicon.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务情况

芯原是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案，以及百余个可供的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP和图像信号处理器IP五类处理器IP，1,400多个数模混合IP和射频IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括IDM、芯片设计公司、以及系统厂商、大型互联网公司及云服务提供商等。

芯原在传统CMOS、先进FinFET和FD-SOI等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力，在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有14nm/10nm/7nm FinFET和28nm/22nm FD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验，并已开始进行5nm FinFET芯片的设计研发和新一代FD-SOI工艺节点芯片的设计研发。此外，根据IMnest统计，芯原是2019年中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体IP授权服务提供商。

2 主要服务情况

公司主要服务为面向消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等广泛应用市场所提供的一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务，具体情况如下：

（1）从一站式芯片定制服务提供商到提供平台化的芯片定制方案，并可以按需要托完成从芯片设计到晶圆制造、封装和测试的全部或部分服务环节，充分利用半导体IP资源和研发能力，满足不同客户的芯片定制需求，帮助客户降低设计风险，缩短设计周期。其中，半导体IP在一站式芯片定制服务中使用外，也可以单独对外授权。

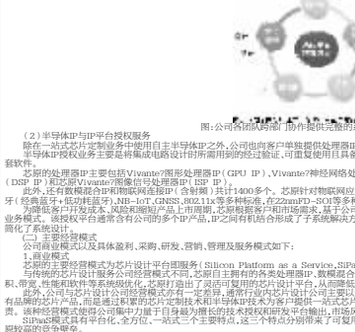
一站式芯片定制服务具体可分为两个主要环节，分别为芯片设计业务和芯片量产业务。①芯片设计业务：主要指为客户提供以下过程中的部分或全部服务，因图形客户对芯片在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面的要求进行芯片规格定义和IP选型，通过设计、实现及验证，逐步将化为能用于芯片制造的版图，并委托晶圆厂根据版图生产工程晶圆，封装厂及测试厂进行工程样片封装测试，从而完成芯片样片生产，最终将经过公司技术人员验证过的样片交付给客户的全周期过程。②芯片量产业务：主要指为客户提供以下过程中的部分或全部服务，即根据客户需求委托晶圆厂进行晶圆制造、委托封装厂及测试厂进行封装和测试，并提供以上过程中的生产管理服务，最终交付给客户晶圆片或者芯片供全周期过程。

2020年度，公司新签订单金额约183.0亿元，主要来自半导体IP授权业务及芯片量产业务。报告期内，公司芯片量产业务同比增长22.49%，增长主要来自2020年四季度起新签量产订单的大幅增长和优质大客户的持续放量。

按照客户特征类型区分，芯原主要为芯片设计公司和IDM、系统厂商和大型互联网公司及云服务提供商等客户提供一站式芯片定制业务。

在芯原服务的客户中，系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体对包含软件的图像编码方案有较高的需求，随着这类客户占比逐年增加，且呈现持续增长趋势，为满足该类客户对系统级图像编码方案的需求，芯原于2020年成立了系统平台解决方案事业部。该部门作为一站式芯片定制业务的延伸，将公司服务范围从硬件拓展至软件，通过为客户提供应用软件支持，可大幅降低客户的研发周期和风险，帮助客户快速响应市场。软件支持服务可增强公司的议价能力，增加客户粘性和黏至软件，扩大公司服务内容的范围，从而进一步扩大公司的业务发展空间。

公司系统平台解决方案事业部将公司的半导体IP、芯片定制服务和软件支持服务等全面有机结合，为客户提供系统平台解决方案。在与大型互联网企业、云服务提供商等客户的合作中，公司的系统平台解决方案与客户提供的服务可形成较为完整的按应用领域划分的系统生态，有助于为相关市场高效率地打造应用产品，帮助客户快速扩大生态范围。


芯原
图像处理器
视频处理器
神经网络处理器
数据处理器
图像信号处理器
音频处理器
IP子系统
IP子系统
IP子系统